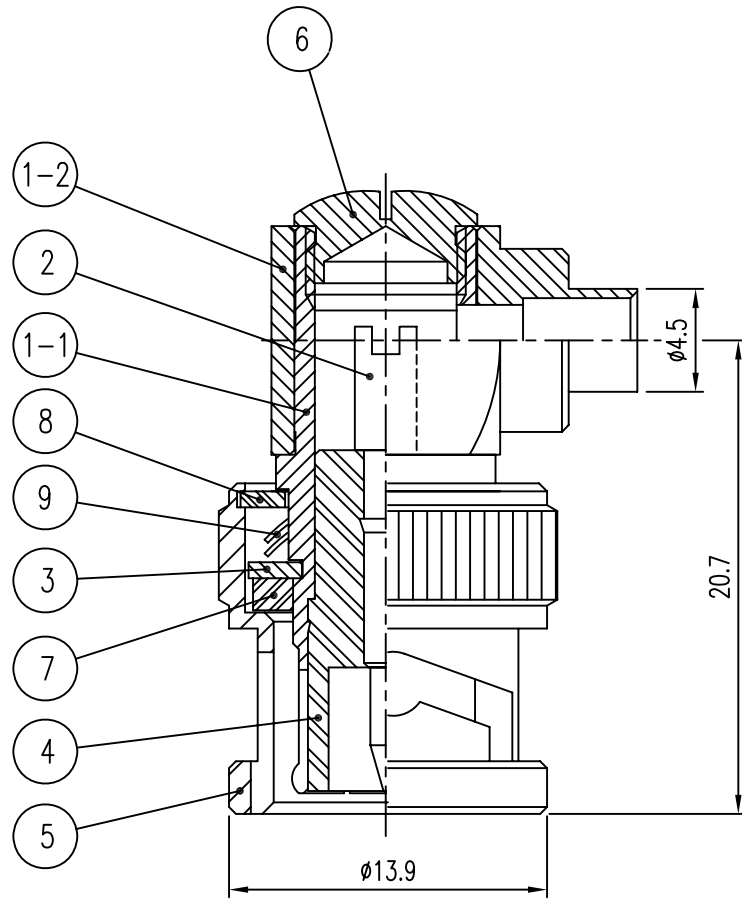


ST	가공									수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)									1	[절번No.201806-0001] 조립성 개선으로 인한 배다 넘시배를 추가	은선영	김인철	2018. 6. 04.	
ST(개선)														



9	SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
8	WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
7	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
6	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCS00022-135/1 (L8003) DCS00004-135/1 (L8003)
5	BNC CAP	1	MBsBD		DCU00044-135/1 (K6001)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00446-N/1 (H6101)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00012-N/1 (G6001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00585-135/1 (E6088)
1	1-2 BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00635-5/1 (D6098)
	1-1 BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00203-5/2 (D6097)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2001. 4. 17.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	BNC-LPC-141	
	재도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4	도번	CN00275-7/1
보호피막처리	적도	3/1	단위 mm	중량			K325-118-000